

Control Your Wafer Quality

 **SNEC PV** POWER EXPO 2009 5/6~5/8

- Shanghai New International Expo Center
- Booth # T658 - Hall E6



MPS 3-134

G&N

Solar Brick Grinder 太阳光伏硅棒研磨抛光机

- 研磨抛光太阳光伏单晶及多晶硅棒
- 硅棒次表面破坏深度(S.S.D.)最小化
- 大幅降低多线切割硅棒破片率1~3%
- 高产能-研磨硅棒四面及斜角仅25分钟!



MX203-6-41q



Solar Wafer Geometry Gauge 非接触式晶圆/太阳光伏电池硅片量测仪

- 非接触式电容感应量测方式
- 最小刻度为0.1um, 重复性误差0.25um
- 测量时间5sec./wafer
- 可测量Thickness, Flatness, Warp, Bow
- 支援WaferMap 3D功能



SemDex 301

ISIS senionics

Non-Contact Layer Thickness Measurement 光学式芯片厚度/翘曲度量测仪

- 适用于Bumped Wafer, Multifoils Wafer in Packaging, Photoresist Layer, MEMS SOI, GaAs, Glass
- 可同时显示多层不同材料厚度(最多8层)
- 量测光点直径最小(min. 20um)
- 单一机台同时适用多种不同芯片尺寸(2"~12")
- 另选配太阳光伏电池片翘曲度及Stress



GL Automation

Solar Cell Wafer Transfer Systems 太阳光伏电池片传输设备

- 高产能、高良率全自动整批次芯片传输设备系统
使用白努力原理之机械手臂组
- 适用各种晶舟: 塑胶、铁弗龙、石英、碳化矽
- 适用湿式蚀刻及扩散制程
- 芯片间距可变, 背对背模式
- 可依不同芯片及片盒客制化设计

Chunson 冲成有限公司
JC's Chunson Limited

TEL:+86-21-6251-5152

FAX:+86-21-6212-7410

Http://www.chunson.com

E-mail:info@chunson.com